

Automatic Dicing Saw DAD3661



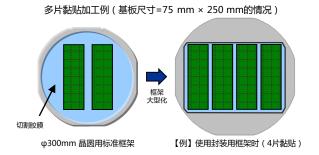
配备可对应大型封装基板的双主轴切割机

最大可对应360 × 360 mm工作物

由选择特殊切割框架或治具工作台,可对应以Fan-out WLP为首的大型化封装基板切割。

对应封装基板的多片黏贴

可将多片封装基板黏贴在1个胶片框架上进行加工。由此可达到削减更换工作物时间而提升生产效率,并实现削减切割胶膜的使用量。





高生产效率

採用双主轴同时切割的双刀切割加工方式,相较于过往机型(单主轴· DAD3350φ300 mm特殊对应机型)生产效率最大可提升90%。 ※生产效率会随工作物尺寸、加工条件而有所变化。

加工品质安定化

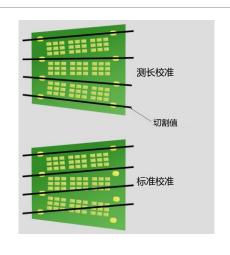
由选配的Sub Chuck table,可于加工中进行磨刀(可对应Full size·75 x 75 mm的磨刀板)。针对容易产生刀片气孔堵塞的玻璃基板等的硬脆材料、或树脂及金属等具延展性的材料,可达成加工品质安定化。

测长校准

对于树脂基板等会产生不规则伸缩的材质,透过在多个点进行校准,可实现高精度的加工。

2.2kW主轴

透过搭载高扭矩、高刚性的2.2kW主轴,可对应玻璃、陶瓷等硬脆材料或厚工作物、透过厚刀片进行开槽等高负荷加工。



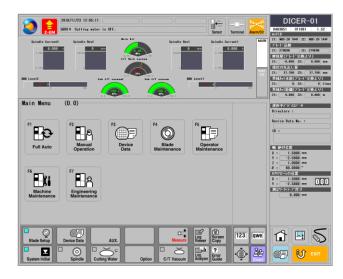
Automatic Dicing Saw DAD3661

操作方便

- 高度操作便利性
 - 19 寸大型显示器、大型按钮构成良好操作便利性
- 机况检测机能
 - 可监测使用量或主轴电流值等
- 操作人员辅助机能
- 自动校准
 - 事先进行个别装置识别(切割位置的登录作业),选择装置 DATA可以完成校准
- 切割槽检测
 - 可自动计测切割道的偏移、切割槽宽度,管理切割品质

空间效率化

将过往皆为外接式的補助机器 (停电对策装置、海外变压器、CO2注入器、升压帮浦机构) 内嵌于机器中,达成空间效率化



19 寸 大型显示器

Specification

Specifecation		Unit	1.8kW	2.2kW (option)
Workpiece size		П	ϕ 300 (360 mm square: DPR)	
X-axis	Cutting range	mm	400	
	Cutting speed	mm/se c	0.1 ~ 1,000	
Y-axis	Cutting range	mm	400	
	Index step	mm	0.0001	
	Index positioning accuracy	mm	0.002/400	
			(Single error) 0.002/400	
Z-axis	Max. stroke	mm	32.2	31.4
	Moving resolution	mm	0.00002	
	Repeatability accuracy	mm	0.001	
θ –axis	Max. rotating angle	deg	320	
Spindle	Rated torque	N•m	0.29	0.70
	Revolution speed range	min ⁻¹	6,000~60,000	3,000~30,000
Machine dimensions (W × D × H)		mm	1,350 × 1,200 × 1,890	
Machine weight		kg	Approx.1,500	

■使用条件

- 请使用大气压露点在-10 ~ -20 ℃,残余油分为0.1 ppm,过滤度在0.01 μ m/99.5 %以上的清洁压缩空气。
- •请将放置机械设备的房间室温设定在20 °C \sim 25 °C之间,并将波动范围控制在 \pm 1 °C以内。
- •请将切削水的水温控制为室温+2 °C (变化波动范围在±1 °C以内) ,将冷却水的水温控制为与室温相同(变化波动范围在±1 °C 以内)。
- •其他,请避免請设备受到撞击及外界的有感振动。另外,请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油污的装置附近。
- 本设备会使用水。
- 万一发生漏水影响,请把本设备安装在有防水性的地板及有排水处理的場所。
- % 为了改进设备,本公司可能在预先不通知用户的情况下,就对本规格实施变更,因此请仔細确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询,请与本公司销售部门联络。

